

お客様各位

平成28年5月吉日

株式会社 岡本工作機械製作所
代表取締役社長
石井 常路

eX-tech2016 出展のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2016マイクロエレクトロニクスショーでの特別企画として開催される eX-tech2016 (エクステック 2016) にポスター出展する運びとなりました。

今回は、ウェーハレベルパッケージ(WLP,WLCSP)用の樹脂、Cuおよびシリコン等の複合材料研削手法、バンプ用 BG テープ基材等を独自の手法で薄層化する研削装置(SGL6)とその技術、およびシリコン貫通電極(TSV)用に新たに開発した研削・研磨・洗浄複合装置(TSV300)をポスター展示いたします。両技術では、弊社が独自に開発した異種材料の同時研削技術を導入することで、従来不可能であった硬軟複合材料や軟々複合材料を高面品位かつ高平坦に同時研削できる技術をご紹介します。

大変お忙しい中とは存じますが、何卒お誘いあわせの上ご来場頂けます様、心よりお待ち申し上げます。

敬具

記

日 時: 2016年6月1日(水)～3日(金)10:00 - 17:00
場 所: 東京ビックサイト 東6ホール
小間番号: マイクロエレクトロニクスショー2016 内 eX-tech2016 **6G-15**
ポスター展示: ・ ウェーハレベルパッケージ用薄層化研削技術と装置(SGL6)
・シリコン貫通電極薄層化用研削・研磨・洗浄複合機(TSV300)
・ハイバンプウェーハの高平坦・薄層化技術(NEW)(GNX200)

[お問い合わせ先] 株式会社岡本工作機械製作所 技術開発本部 開発部
〒379-0135 群馬県安中市郷原 2993 [TEL:027-385-5112](tel:027-385-5112) Fax:027-385-5122

